|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |
| Project: | MSP-DSP | |  | | Date: | | 28-03  -2020 | |
| Part: | DualCell V2 | |  | | Revision: | | A | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| Designer | KAME |  | |  | |  | |  | |
| Reviewer | SKH |  | | Time: | |  | |  | |
| Reviewer | JBJ |  | |  | |  | |  | |
| Reviewer | JOVE |  | |  | |  | |  | |
| Reviewe | HMDS |  | |  | |  | |  | |
| Item nr. | Reviewer | Description | | Priority (1 – 3) | | Comment | | Decision | |
| 1 | SKH | Placer Via´s I Pads, Slet Baner på toppen og træk Fofrbindelser I Layer 2  Sammen med testPads (Anode & Cathode) | | 2 | |  | | Done | |
| 2 | SKH | Kan Komponenter flyttes til Chassis skrue ? | | 2 | |  | | Done | |
| 3 | SKH | Saml Chassis track køres på layer 3 Midlayer 2 | | 2 | |  | | Done | |
| 4 | SKH | Anode + Commond Polygon Layer 3 | | 2 | |  | | Done | |
| 5 | SKH | Layer 3 (Midlayer2) Ændre Polygon for at bevare Anode lag og fjerne Commond Signal fra Bottom Layer | | 2 | |  | | Done | |
| 6 | SKH | Skal ændres til IFS No på PCB , ville flytte det til ( Mec6) Notation bottom - white low-outgassing epoxy | | 3 | |  | | Done | |
| 7 | SKH | Lav område for Area for manufacturer serial number ( Mec 7 ) samme sted som IFS nummer | | 3 | |  | | Done | |
| 8 | SKH | Placere via og køres i Layer 2 hvis muligt som ECSS-Q-ST-70-12 beskriver | | 2 | |  | | Done | |
| 9 | SKH | Dual Cell V2 (Afstand forskellig på Flex 1.4mm og på Dual Cell 1.2 ) | | 2 | |  | | Done | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |